

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 1 月 27 日 (27.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/007751 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C08L 101/10, C08K 3/16, 3/18, C09J 201/10, C09K 3/00, C09D 201/10
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/010549
- (22) 国際出願日: 2004 年 7 月 16 日 (16.07.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2003-277042 2003 年 7 月 18 日 (18.07.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): コニシ株式会社 (KONISHI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5410045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目 6 番 10 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 森 茂樹 (MORI, Shigeki) [JP/JP]. 野村 幸弘 (NOMURA, Yukihiko) [JP/JP]. 伊豫 和裕 (IYO, Kazuhiro) [JP/JP]. 佐藤 慎一 (SATO, Shinichi) [JP/JP].
- (74) 代理人: 三好 秀和 (MIYOSHI, Hidekazu); 〒1050001 東京都港区虎ノ門 1 丁目 2 番 3 号 虎ノ門第一ビル 9 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GI, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: CURABLE RESIN COMPOSITION AND COLD-SETTING ADHESIVE

(54) 発明の名称: 硬化性樹脂組成物及び常温硬化接着剤

(57) Abstract: A moisture-curable resin composition which comprises a curable resin having a silicon-containing characteristic group in the molecule and a curing catalyst which is either a Lewis acid selected from the group consisting of metal halides and boron halides or a complex of the Lewis acid. It quickly cures at ordinary temperature. The silicon-containing characteristic group is represented by the formula $-\text{SiX}^1\text{X}^2\text{X}^3$ or $-\text{SiR}^1\text{X}^1\text{X}^2$ (wherein X^1 , X^2 , and X^3 may be the same or different and each represents a hydrolyzable group and R^1 represents a C_{1-20} (un)substituted organic group). When the silicon-containing characteristic group is $-\text{SiR}^1\text{X}^1\text{X}^2$, the curable resin further contains in the molecule a polar element which is a urethane bond, thiourethane bond, urea bond, thiourea bond, substituted urea bond, substituted thiourea bond, amide bond, sulfide bond, hydroxy, secondary amino, or tertiary amino. The ingredients can be formulated so as to constitute a two-pack type adhesive in which the curable resin and the catalyst for solidification are separately packed.

[続葉有]

WO 2005/007751 A1